

***winbond***

*We Deliver*

**華邦電子股份有限公司**

**—利基型記憶體領導廠商**

**2015年 暑期研習計畫**

# 公司簡介

---

# 華邦為利基型半導體記憶體領導廠商

- 半導體記憶體產業經過多年的競爭與整併，產業競爭態勢已經重塑，由「完全競爭市場」趨向「寡佔市場」，產品價格趨於穩定。
- 「行動化」與「智慧化」的趨勢驅動半導體記憶體的需求持續成長，推動營收及獲利顯著提升。
- 華邦成立於 1987 年，擁有 12 吋晶圓製造廠與卓越的產品與製程技術研發團隊，多年來一直是世界利基型記憶體市場的領導廠商，以良好的成本結構，靈活的產能調配和不斷精進的品質水準因應市場脈動，滿足客戶需求，穩定帶動公司的成長與獲利；在行銷策略上，則致力於經營與世界一流客戶的長期關係。放眼物聯網時代，華邦亦領先同業，自主研發先進的製程技術與新型態記憶體晶片，導入低功耗，高性能與安全加密的技術與產品。

# 產品策略

## ■ DRAM 產品

以所擅長的高速度和低功率記憶體核心設計技術，推出包含 Specialty DRAM、Mobile RAM 系列產品，除了在手持裝置應用、消費電子及電腦周邊市場都能見到華邦的產品外，更佈局於良品裸晶圓、車用、工業用電子等高門檻、高品質要求的應用。

## ■ 快閃記憶體產品

聚焦中低密度之 NOR Serial Flash 與 NOR Parallel Flash 產品，以自有十二吋晶圓廠搭載先進製程技術生產，具低耗電、體積小及成本結構佳之特性，為世界級 NOR Flash 主要供應廠商，未來將進一步以 NAND Flash 和創新的新形式記憶體技術建構更完整之產品線，以符合多元市場需求

# 產品組合及4C應用

Computers

Cars



Communications

Consumers

# 全球服務據點

Winbond Electronics Corp.  
CTSP Site /Taipei Office /Jhubei Office



Japan  
Winbond Electronics Corporation Japan



America  
Winbond Electronics Corporation America



全球員工2,350人



Hong Kong  
Winbond Electronics (H.K.) Limited



Mainland China  
Winbond Electronics (Suzhou) Limited



Israel  
Winbond Technology Ltd



# 人性化管理及績優友善職場

103年度「績優健康職場 團體組-十年成效優良獎」



## ■ 人性化管理

重視工作與生活的平衡，致力塑造正向組織氛圍，打造活力熱情與不斷創新的企業

## ■ 完整的教育訓練

個人學習計畫、線上知識分享平台、創新論壇、雲端圖書館、外訓課程補助、提供在職進修機會、多元的學習管道等

## ■ 完善的工作環境

員工餐廳、便利商店、員工專屬停車位、會議室、醫護中心、準媽媽休息室及哺乳室

## ■ 健全的福利與關懷制度

員工及員工親屬團保、員工申訴管道、各式溝通會議及講座、健康促進活動



# 2015暑期生研習計劃

---



# 暑期研習計劃

- 暑期研習計劃係於每年暑假期間(6月至9月)提供為期兩個月到公司研習的機會給碩士班研究生或博士候選人。
- 目標：透過產學交流，提供研習生寶貴實習機會，縮小產學差距，增進研習生對記憶體研發工作的興趣。
- 在研習期間，研習生會在經驗豐富的Mentor帶領下，參與一些工作專案。並於研習結束前，就研習結果對內部同仁進行簡報。
- 指派給研習生之暑期研習專案，會依華邦業務發展之需要逐年不同。

# 2015 年暑期研習主題

NO	研習主題	工作地點
1	Flash memory life time projection	中科
2	Thin capacitor dielectric material survey for advanced DRAM technology	
3	RRAM reliability improvement / model building	
4	DRAM Advanced Technology Development	
5	1. DRAM process improvement 2. Integration of semiconductor process 3. Low power DRAM process improvement	
6	1. Advanced DRAM process development 2. Advanced DRAM device development 3. DRAM experimental analysis preparation	
7	記憶體操作及量測	

# 暑期研習提供您…

## 訓練與成長

- 經驗豐富的Mentor帶領
- 繳交實習報告及成果報告

## 寶貴的工作經驗

- 結合理論與實務
- 體驗研發工程師的生活
- 認識資深的前輩及結交共同興趣的朋友

## 薪資福利

- 實習津貼：NTD 30,000~33,000/月(含稅)，依所具備的職能核給
- 勞工保險及全民健保，餐廳伙食補助
- 提供免費住宿(工作地點在台中者)
- 提供海外生往返就學地經濟艙機票一張

# 甄選流程

## 【申請資格】

碩士班生或博士候選人，主修電子工程、物理、材料、資訊、數理統計及相關系所，有興趣從事半導體研發者。

(請附履歷、研究論文等資料寄”至：[HRCampus@winbond.com](mailto:HRCampus@winbond.com) )

承辦人進行初步資格篩選(初審)

將符合初審之申請者履歷、研究論文等資料提供公司研發主管審閱

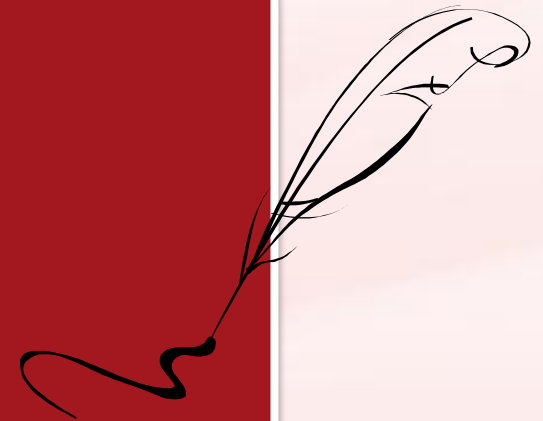
由研發主管、人資進行職能面談

寄發錄取通知及報到事項說明

## 【申請期間】

即日起~2015年5月30日止

- 若有任何問題，請隨時Email與我們聯絡  
[HRCampus@winbond.com](mailto:HRCampus@winbond.com)
- Winbond 網站協助您更了解華邦  
<http://www.winbond.com/>



這個暑假....

加入華邦

這個specialty memory 公司

---

將讓您在這個暑假擁有

**special memory !**